

株主各位

京都市南区上鳥羽上調子町5番地
T O W A 株 式 会 社
代表取締役社長 岡田博和

第46回定時株主総会における株主さまからの事前質問に対する回答

第46回定時株主総会では、その目的事項につきまして、株主さまより事前質問をお受けしました。お寄せいただいたご質問につきまして、下記のとおり回答させていただきます。

記

	ご質問内容	回答内容
1	株価が1万円以上になり、株購入金額が50万円以上になっていますが、半期内に分割の予定はありますか？ 分割の予定が無い場合、それは何故ですか？	投資単位に関し、東京証券取引所が求めている望ましい水準としては5万円以上 50万円未満と認識しておりますが、分割につきましては、現時点において未定です。株式市場の動向、当社株式の株価水準、流通状況、株主構成の変化による既存株主への影響度合い等を総合的に勘案しながら、慎重に検討を続けてまいります。
2	増配をお願いしたい。 また、配当性向について、目標値を設定しているのであれば教えてほしい。	半導体業界は製造技術の変化が激しく、積極的な研究開発や設備投資が必要なことから、安定配当を方針として掲げておりますので、配当性向については、特に決めておりません。 私どもは、これまでもお客様の動向に鑑みて先手先手で工場建設やM&Aなどを行ってまいりましたが、こうした積極的な投資が今日の業績拡大につながったと考えており、今後も積極的な研究開発や設備投資が必要なことから、安定配当の方針に基づき、今期につきましては1株当たり20円増配し、60円を計画しております。 配当の方針についてはいろいろなお考えがあるかと存じますが、安定配当の方針は、当社の多くの株主様にご支持いただいているものと考えております。
3	中国との取引について、チャイナリスクをどのように考えているのか。それに対してどの様なリスクヘッジをとっているのかお伺いしたい。	中国政府は国策として半導体産業の内製化に積極的な支援を行っております。当社におきましても、近年中国での受注・売上が大幅に増加し、これは、過去当社が行ってきた工場増築やM&Aなどの中国地域での積極的な設備投資の結果と考えております。

		<p>株主様からご指摘いただいておりますとおり、中国での事業展開には、米中貿易摩擦や台湾問題、債務超過等のリスクがございますが、当社では新規のお客様との取引においては装置受注時に前受金を頂き、出荷時には代金の90%の入金を頂くなど、リスクの低減を図っております。</p> <p>今後も米中貿易戦争や台湾問題等の動向には注視しつつ、引き続き積極的な事業展開を行ってまいります。</p>
4	<p>世界各国が自国内での半導体生産能力の増強に向けて動いているようですが、今後の半導体市場はどのように発展していくとお考えでしょうか。</p>	<p>AI・IoT・5G・ビッグデータ・自動運転など、半導体の活躍分野は飛躍的に拡大しており、世界の主要各国・地域において、経済成長の起爆剤として、また経済安全保障の観点から、半導体産業への積極的な投資が進められています。</p> <p>経済産業省が2019年に予想した2030年の世界の半導体市場規模は当時の約2倍となる100兆円でしたが、その後の生成AIの登場により、2025年には前倒して100兆円を超えると予測されるなど、今後の半導体市場は、半導体需要の高まりと世界的な供給体制の拡がりにより、一層力強く成長していくものと考えています。</p>

以上